

テクニカルデータシート

Box TOSA用 TEC

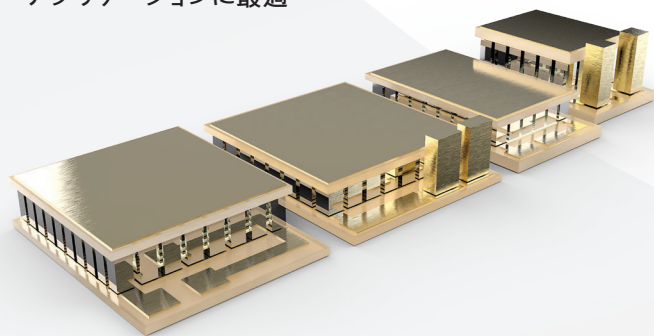
Phononicの箱型TOSA (transmit optical subassembly、送信用光サブアセンブリ)レーザーパッケージ用高性能TECソリューションは、100G以上の

アプリケーションに優れた冷却を提供します。これらは、QSFPトランシーバパッケージでうまく機能し、共同設置データセンターや地域データセンターの拡張で要求される高い冷却性能を備えた長距離伝送の要件に完全に適合します。

また、当社は単一波長の100G+アプリケーションでもお客様と協力しています。パッケージ内の差別化と1.6Tまでのサポートオプションにより、当社のTECシリーズは、速度や距離などの要因に関係なく、

お客様の箱型TOSAレーザーパッケージのニーズを満たします。将来の製品ロードマップの計画に、ぜひ当社の専門知識をご活用ください。当社のソリューションは標準的な製品に限らず、お客様のニーズに合わせて設計することもできます。

長距離および高速伝送
アプリケーションに最適



特長

- 低消費電力
- より高いヒートポンプ密度
- 100G-1.6Tアプリケーションをサポート
- 長距離に対応
- I温度およびC温度動作範囲に対応
- アプリケーション専用設計可

エンド顧客のアプリケーション

- CFPx MSAトランシーバ
- OSFP、QSFP28およびQSFP-DD (Quad Small Form Factor Pluggable)トランシーバ
- 100G DR1/LR1/LR4 TOSA
- 400G DR4/FR4/LR4および800G DR4/DR8/FR8 TOSA
- 100G/400G/800Gコヒーレント
- 高速データLAN-WDMおよびDWDM (高密度波長分割多重方式)
- 無線フロントホールアプリケーション用I温度QSFP28 TOSA

統合オプション

- 裸線ボンディングパッド
- ワイヤーボンディングポスト
- 低温側の電気接続
- 高温はんだ
- はんだ付け前の錫メッキ
- パターン化された低温側メタライゼーション
- 低温側サーミスタ取り付け済み
- オートメーション対応パッケージ

利点

- **きわめて低い電力消費:**一般的なTEC性能より最大30%低い消費電力を実現。
- **高いヒートポンプ密度:**非常に薄いTECで最大60%高いヒートポンプ密度を実現 - 当社のpico-TECプラットフォームは、データセンターおよびテレコミュニケーションのアプリケーションに最適です。
- **卓越した設計とアプリケーションのサポート:**当社のノウハウをご活用ください。お客様とご相談の上、最初から適切な設計を行い、市場投入までの時間を短縮します。

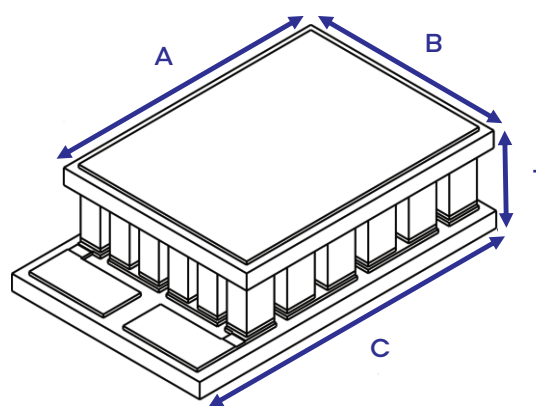
製品ポートフォリオ

品番	TEC寸法				TEC性能(Thot = 75°C)					AC抵抗@ 25°C (Ω)
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	T (mm)	最適熱負荷 (mW)	Qc Max (W)	DT Max (°C)	V Max (V)	I Max (A)	
FBM-017990	8.50	2.70	9.30	0.93	590 - 1950	5.9	88	5.28	1.99	1.72
FBP-018318	3.90	4.20	4.90	0.67	580 - 1900	5.8	86	10.84	0.97	7.71
FBM-016859	4.10	4.10	4.90	1.00	500 - 1650	5.0	89	5.28	1.69	2.03
FBM-016140	4.20	2.90	4.90	1.00	420 - 1400	4.2	89	4.46	1.68	1.73
FBM-016936	4.20	4.50	5.00	0.85	290 - 960	2.9	89	3.97	1.31	2.01
FBM-016916	2.80	2.70	3.50	1.30	240 - 800	2.4	89	3.46	1.23	1.83
FBM-017066	4.10	2.20	4.85	0.93	180 - 600	1.8	89	3.64	0.90	2.63
FBB-017256	3.00	4.20	3.80	1.60	130 - 430	1.3	93	2.66	0.85	2.18
FBM-017996	6.45	2.70	7.10	0.93	600 - 2000	6.1	88	3.95	2.74	0.93

*最適熱負荷は、TECが最高効率状態またはそれに近い状態で動作する低温側の 負荷範囲です。高温側の温度は75°C、低温側の温度は45°C~55°Cです。

アプリケーションについて

最大限の信頼性を得るためには、結露のない環境・周囲温度 85°C以下でTECを保管および使用することを推奨します。推奨される設置方法は、エポキシ樹脂による接着または金属化セラミックを使ったはんだ付けです。さらに詳しい情報や、お客様のアプリケーションに適したTECの選定については、当社のアプリケーション・エンジニア(電話: +1.844.476.4202または www.phononic.com/contact/)にご相談ください。



詳しくは:



Copyright © 2024 Phononic, Inc. All rights reserved. V03_0424
Phononic, Inc. 800 Capitola Dr #7, Durham, NC 27713 | phononic.com

PHONONIC